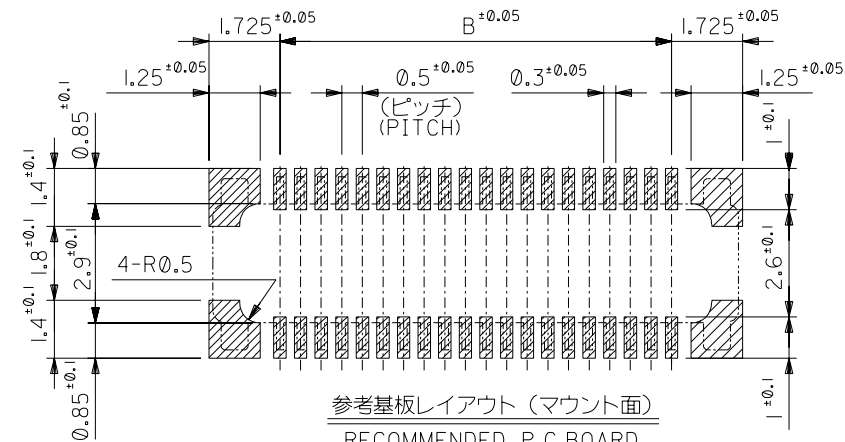
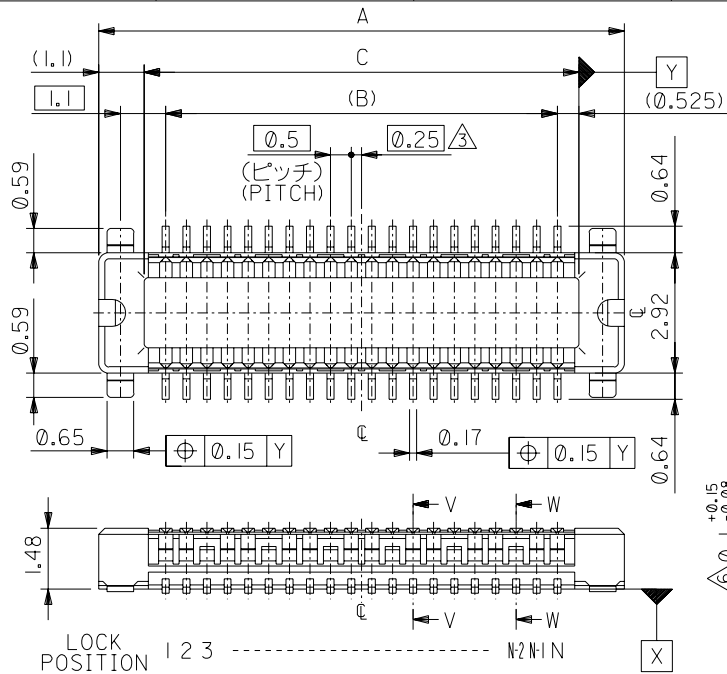
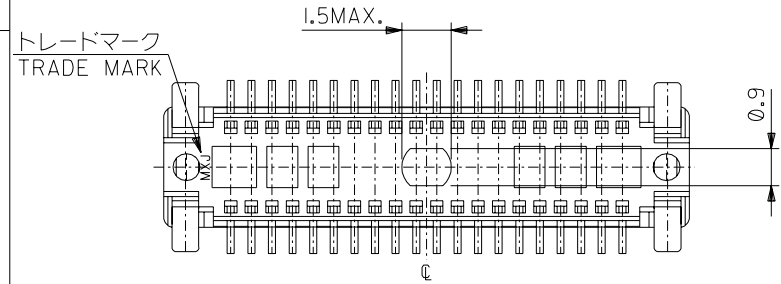
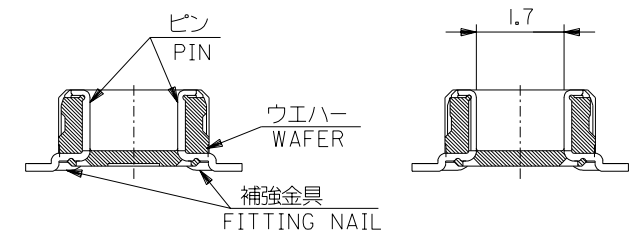


DWG. NO.
SD-53949-006



参考基板レイアウト (マウント面)
RECOMMENDED P.C.BOARD
PATTERN DIMENSION. (REF.)
(MOUNTING AREA)



NONE	20.55	19.5	22.75	53949-0871	80	
	18.05	17.0	20.25	53949-0771	70	
10,21	15.55	14.5	17.75	53949-0671	60	
53949-**71	4,10,16,22	13.05	12.0	15.25	53949-0571	50
MODEL NO.	LOCK POSITION	C	B	A	MATERIAL NO.	CIRCUIT

材料 MATERIAL	SHEET 2 OF 2 参照 REFER TO SHEET 2 OF 2		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		
仕上げ FINISH	//		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
適用電線範囲 WIRE RANGE	//		TITLE 名称 0.5 B-To-B PLUG Assy WITH NAIL (Hgt=2.5) -LEAD FREE-		
被覆外径 INS. RANGE	//		DRAWN BY '04/02/16 H.KAWABATA CHK'D BY '04/02/16 K.TOJO DWG. NO. SHEET 1 OF 2 REV SD-53949-006 0		
角度 ANGLE	±3°	新規作成 PROPOSED (J2004-2611)	DR. 日付 DATE	DR. 日付 DATE	尺度 SCALE
30以上 OVER	+0.3	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. 日付 DATE	尺度 SCALE
10以上 OVER 30未滿 UNDER	+0.25	0		DR. 日付 DATE	尺度 SCALE
未滿 10 UNDER	+0.2			DR. 日付 DATE	尺度 SCALE
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

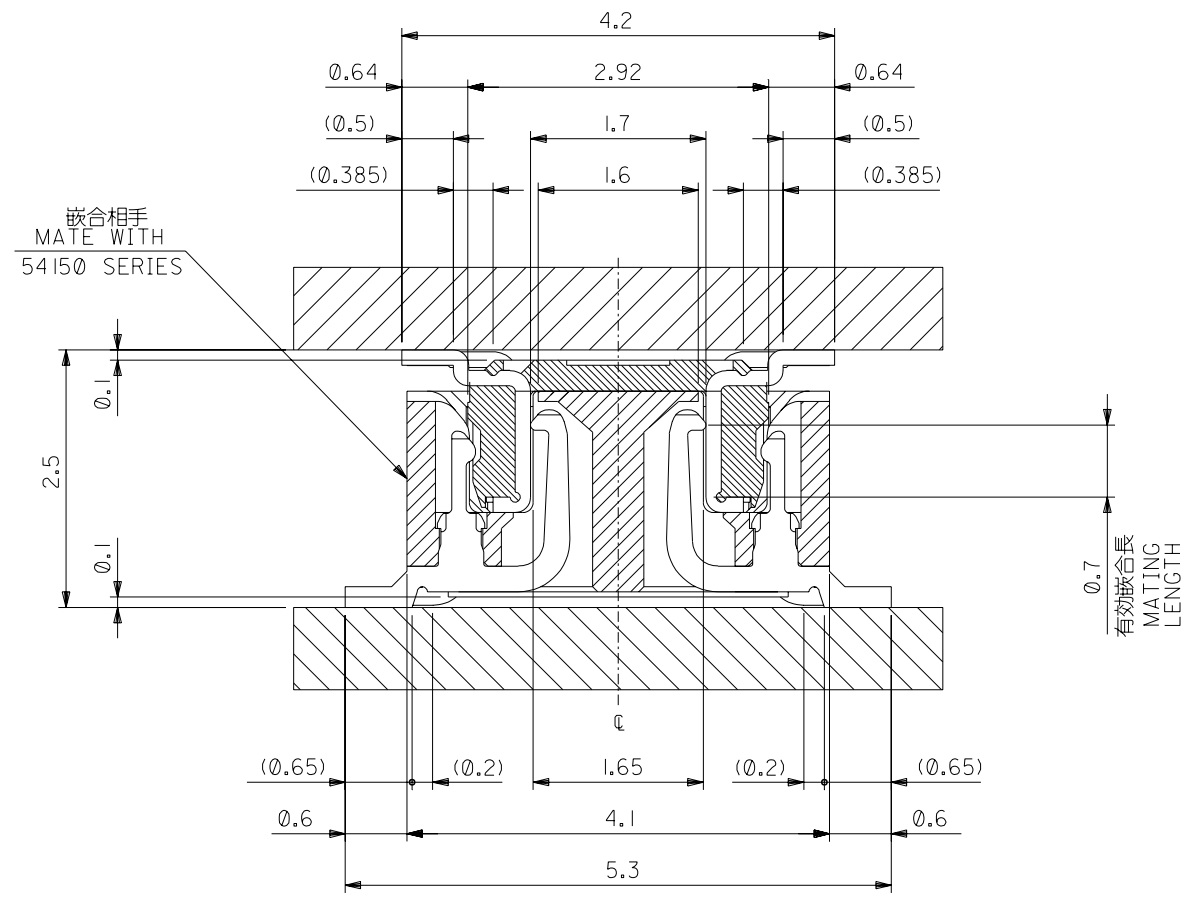
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当該の許可なく複製を禁止する。 EN-0 IC(032)MXJ-32

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

SD-53949-006.S01

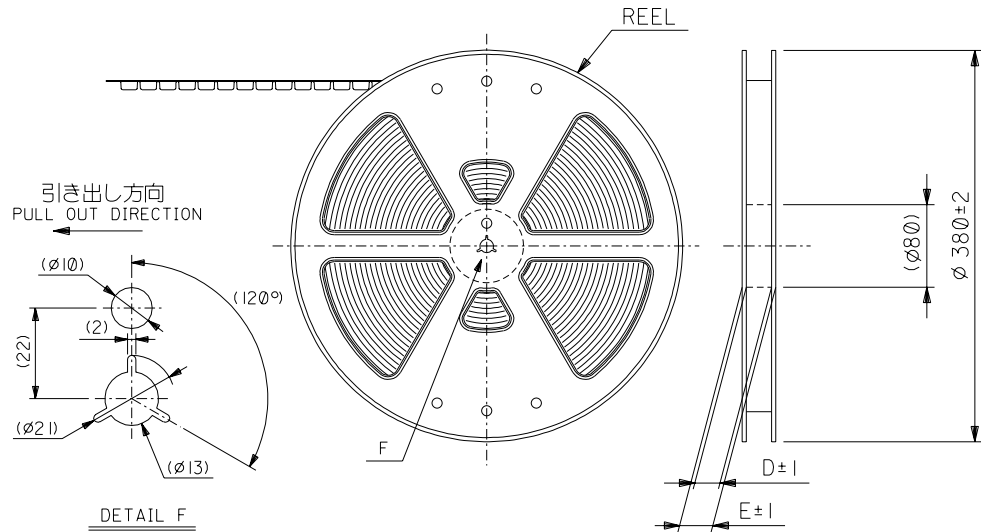
注記 NOTES:

- 1 使用材料 MATERIAL
 ハウジング：液晶ポリマー (LCP) ガラス充填 UL94V-0 (黒)
 HOUSING : LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP)
 (GLASS FIELD)UL94V-0 (COLOR:BLACK)
 ターミナル：黄銅 (t=0.15)
 TERMINAL : BRASS(t=0.15)
 補強金具：リン青銅 (t=0.15)
 FITTING NAIL : PHOSPHOR BRONZE(t=0.15)
- 2 メッキ仕様 PLATING
 コンタクト部：金メッキ
 CONTACT AREA : GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
 テール部：金メッキ
 TAIL AREA:GOLD 0.4 MICROMETER MINIMUM
 ターミナル部下地メッキ：ニッケルメッキ
 UNDER PLATING : NICKEL (TERMINAL AREA)
 1.5 MICROMETER MINIMUM
 補強金具：錫メッキ
 FITTING NAIL : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
 補強金具下地メッキ：ニッケルメッキ
 UNDER PLATING : NICKEL (FITTING NAIL)
 1.0 MICROMETER MINIMUM
 (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
 APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
- 4 嵌合相手：54150シリーズ。
 MATE WITH : 54150 SERIES.
- 5 テール及びネイルの平坦度は、0.1MAX。
 TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAX.
 テール部に適用。
 APPLY TO THE TAIL AREA.
 テールとネイルのズレ量。
 OFFSET BETWEEN TAIL AND NAIL.
8. 本製品は 53949-***I の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53949-***I.



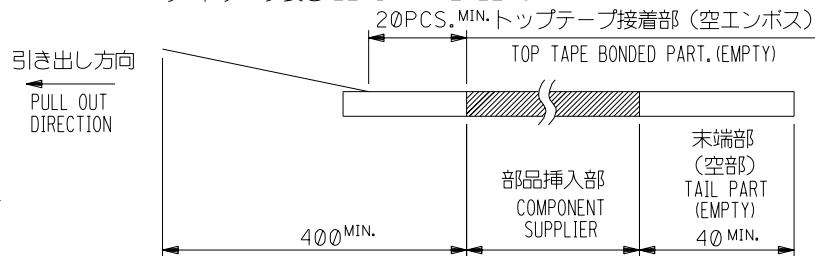
嵌合断面図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)

角度 ANGLE		±3°	材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30 以上 OVER		+0.3	仕上げ FINISH		//	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER		+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE		//	TITLE 名称 0.5 B-To-B PLUG Assy WITH NAIL (Hg+=2.5) -LEAD FREE-
10 未満 UNDER		+0.2	被覆外径 INS. RANGE		//	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV
一般公差 GENERAL TOLERANCES			① 新規格作成 PROPOSED (J2004-2611) 記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD DR. CHK. 日付 DATE	DRAWN BY '04/02/16 H.KAWABATA APP'D BY '04/02/16 M.SASAO	CHK'D BY '04/02/16 K.TOJO 尺度 SCALE //	SD-53949-006 0



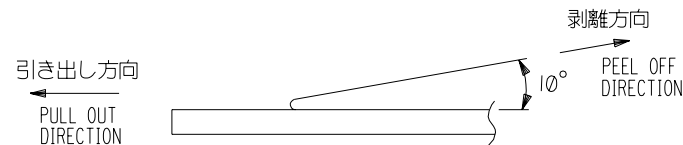
NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-53949-006 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-53949-006.
- 梱包数量：3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度：0.1~1.3N {10~130gf} (剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1~1.3N {10~130gf}
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE (PP))
トップテープ (TOPTAPE) : PET , PE , PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) (POLYSTYRENE (PS))
リサイクル材を含む (RECYCLE MATERIAL CONTAINED)
- 本製品は 53949-***8 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53949-***8.

				材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		—#—		0.5 B-To-B PLUG Assy W/NAIL (Hgt=2.5) Embstp Pkg -LEAD FREE-	
角度 ANGLE		±3°		DRAWN BY '04/02/16 H.KAWABATA		CHK'D BY '04/02/16 K.TOJO		DWG. NO. (SHEET 1 OF 3) REV	
30 以上 OVER		+0.3		DR. '04/02/16 M.SASAO		尺度 SCALE		SD-53949-007 0	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER		+0.25		記号 LTR		REVISION RECORD			
10 未満 UNDER		+0.2		DR. '04/02/16 M.SASAO		尺度 SCALE			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				DR. '04/02/16 M.SASAO		尺度 SCALE			

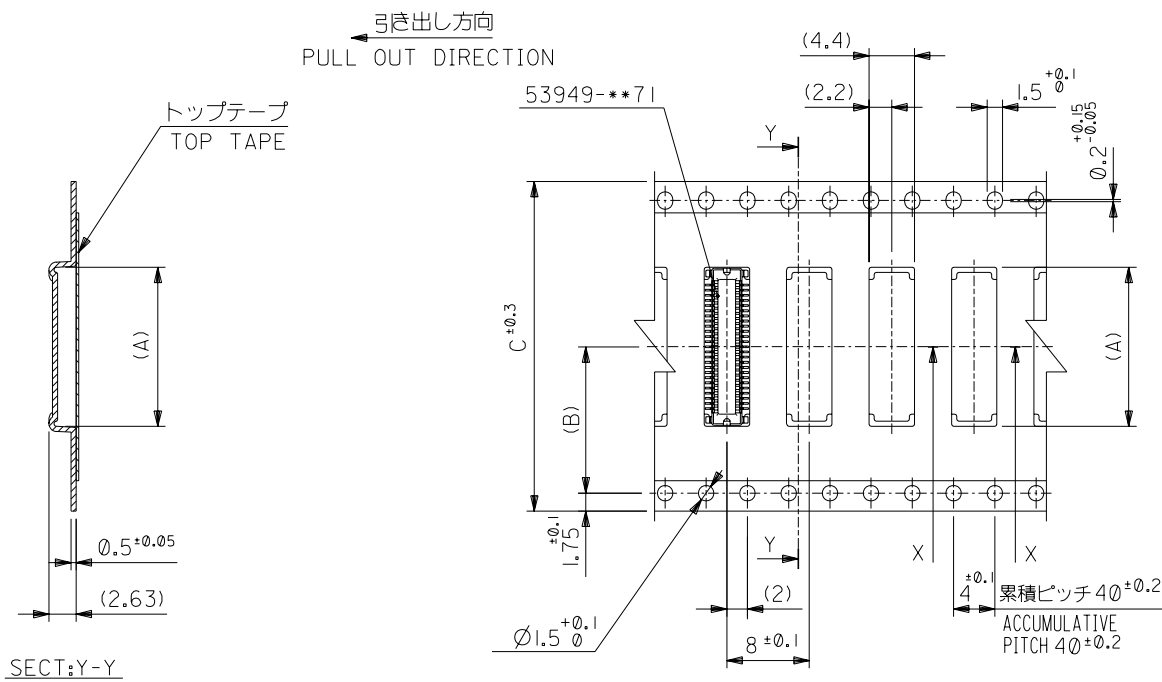
E

D

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A



SECT:Y-Y

SECT:X-X

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

53949-**78	32	37.4	33.4	32	14.2	20.45	53949-0778	70
						17.95	53949-0678	60
						15.45	53949-0578	50
MODEL NO.	CARRIER TAPE WIDTH	E	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	CIRCUIT
							MATERIAL	参照 SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3
							MATERIAL	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
							仕上げ FINISH	—#—
							適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
							被覆外径 INS. RANGE	—#—
							DRAWN BY '04/02/16 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/02/16 K.TOJO
							APP'D BY '04/02/16 M.SASAO	尺度 SCALE —#—
							DWG. NO. (SHEET 2 OF 3)	REV
							SD-53949-007	0

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.5
10以上 OVER 30未滿 UNDER	±0.25
10未滿 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
0	新規作成 (J2004-2611)	Y.K. K.	'04/02/16

E

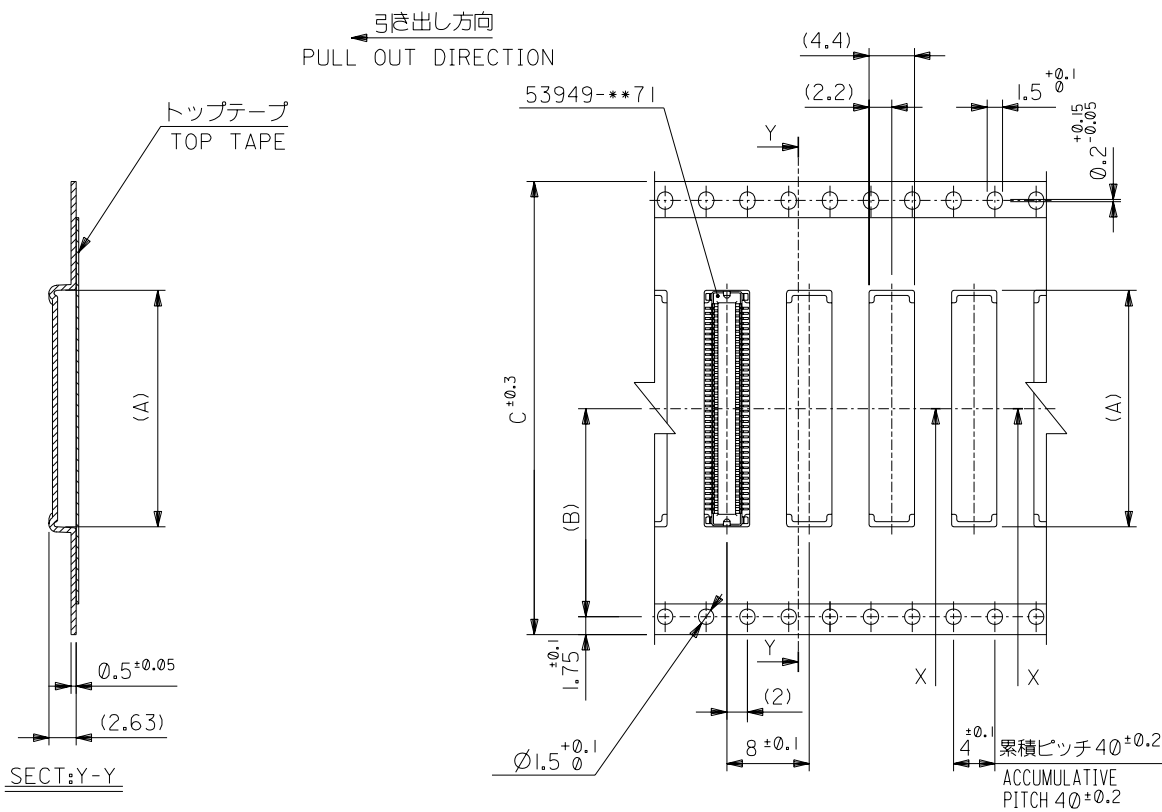
D

C

B

A

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

53949-**78	44	49.4	45.4	44	20.2	22.95	53949-0878	80
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	CIRCUIT
							MATERIAL	
							SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3	
							材料 MATERIAL	
							仕上げ FINISH	—#—
							適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
							被覆外径 INS. RANGE	—#—
							DRAWN BY '04/02/16 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/02/16 K.TOJO
							APP'D BY '04/02/16 M.SASAO	尺度 SCALE
							新規作成 PROPOSED (J2004-2611)	'04/02/16
							変更内容 REVISION RECORD	
							記号 LTR	日付 DATE
							一般公差 GENERAL TOLERANCES	

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.5
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.5 B-To-B PLUG Assy
W/NAIL (Hgt=2.5) Embstf
Pkg -LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV
SD-53949-007 0

SD-53949-007.S03